

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 26 年 11 月 27 日 (2014.11.27)

【公開番号】特開 2013-98332 (P2013-98332A)

【公開日】平成 25 年 5 月 20 日 (2013.5.20)

【年通号数】公開・登録公報 2013-025

【出願番号】特願 2011-239444 (P2011-239444)

【国際特許分類】

H 0 1 L 23/50 (2006.01)

H 0 1 L 23/12 (2006.01)

H 0 1 L 25/04 (2014.01)

H 0 1 L 25/18 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 23/50 R

H 0 1 L 23/12 5 0 1 T

H 0 1 L 25/04 Z

H 0 1 L 23/50 X

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 10 月 15 日 (2014.10.15)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 4】

図 5 (A) はリードフレーム 10 の表面、図 5 (B) はその裏面の平面構成をそれぞれ表すものである。図 5 の ドット で表した領域は、図 5 (A) は表面から、図 5 (B) は裏面からそれぞれ一定の厚みだけ削られ、他の部分に比べて薄くなっている箇所を表している。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 5】

リードフレーム 10 は、例えばメッキされた銅 (Cu) により構成され、チップ搭載領域 11 (ダイパッド)、端子 12 (信号端子)、リード領域 13 A および端子 12 とリード領域 13 A との間の間隙 14 を有している。間隙 14 と端子 12 との間には端子 12 を支持する張出部 15 (図 2) が設けられている。図 5 (A) の ドット 領域は張出部 15、図 5 (B) の ドット 領域はリード領域 13 A である。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 9】

続いて、封止樹脂 41 の表面に製品名等のマーク 54 を刻印した後 (図 12)、図 13 に表したようにカッター等により 切断線 55 でリードフレームシートからリードフレーム

【 手 続 補 正 4 】

【補正対象書類名】明細書

【補正方法】変更

【補正の内容】

半導体チップ21A, 21B, 21Cは互いの電極パッド同士がワイヤ31により電氣的に接続され、リードフレーム10(チップ搭載領域11)に搭載されている。即ち、この半導体装置2は所謂マルチチップの構成を有するものである。

【補正対象書類名】図面

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 図 1 3 】

